



2007年12月3日
芝浦メカトロニクス株式会社

多段積層パッケージ用高精度ダイボンダ 「FTD-7000シリーズ」を発表

芝浦メカトロニクス株式会社（社長：森田 茂樹、横浜市栄区笠間2-5-1）は、フラッシュメモリやシステムLSIなどの多段積層パッケージに最適な高精度・高荷重、薄厚ダイ対応のダイボンダを開発し、2007年12月より受注を開始いたします。

本装置は、12月5日から開催されるSEMICON Japan 2007に実機出展します。

1. 開発の背景

近年、携帯電話などデジタル機器は、画像や音楽、動画データを保存するようになり、メモリの大容量化が飛躍的に進んでいます。大容量を実現するためパッケージの形態は、多段積層化やウェーハ薄厚化が進んでおり、MCP（Multi Chip Package）の需要が拡大しています。

当社では、ウェーハの多段積層化・薄厚化に対応した高速/高精度ダイボンダ「FTD-7000シリーズ」を開発しました。

2. プリサイサタイプ「FTD-7000P」の特長

1) 高精度

プリサイサステージ上の安定した状態で薄厚ダイの高精度位置認識が可能なことに加え、高剛性ボンディングヘッドを搭載することにより、アライメント精度15 μ m(3)の高精度位置決めを実現。

2) 高生産性

ボンディングヘッドとピックアップヘッドを独立させたプリサイサ方式により、ボンディング時間中に次のピックアップができるため、プロセス時間の長いDAF（Dia Attach Film）接合製品に最適。

* DAFはチップの積層に不可欠な粘着フィルム

芝浦メカトロニクス株式会社



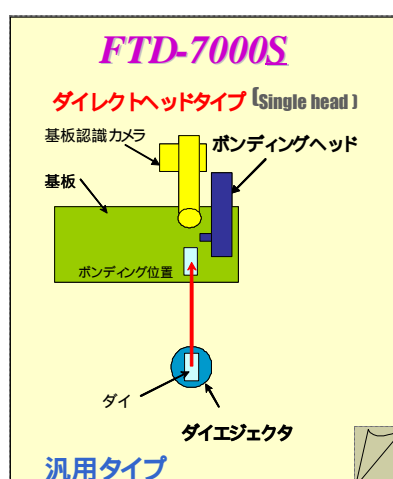
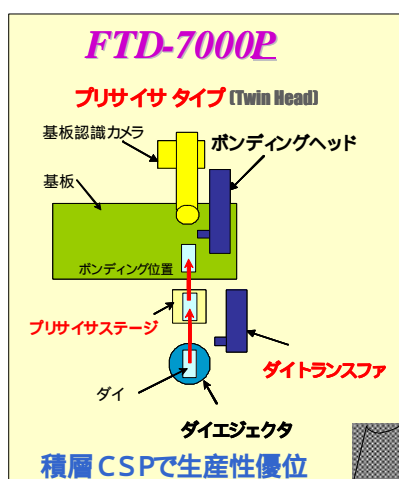
3) 低衝撃ピックアップ / 高荷重ヘッド

薄厚ダイのピックアップに最適な低衝撃ピックアップヘッドと最大50Nの高剛性高荷重ヘッドを搭載。

その他、ボイドレス対策やスペーサレスDAFなどの最新技術に対応します。ボンディングプロセスはDAFとエポキシの両プロセスに対応していますので、リードフレームを含めた従来パッケージにも使用可能です。

3. ボンディングヘッド部構成図

プリサイサタイプの「FTD-7000P」とダイレクトヘッドタイプの「FTD-7000S」の構成を示します。



4. 今後の展開

プリサイサタイプ「FTD-7000P」、汎用タイプのダイレクトヘッドタイプ「FTD-7000S」のラインアップで、多様な用途に応じた最適なシステムを提案します。



5. 装置外観写真



以上

本件お問い合わせ先 : 芝浦メカトロニクス(株) 広報室 葛城 誠一

TEL 045-897-2425

FAX 045-897-2470